股票简称：伟测科技　　股票代码：688372

上海伟测半导体科技股份有限公司

Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd.

上海市浦东新区东胜路38号A区2栋2F

首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构（主承销商）

方正证券承销保荐有限责任公司
FOUNDER FINANCING SERVICES CO.,LTD

（北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层）

二〇二二年十月二十五日

特别提示

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“伟测科技”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于2022年10月26日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

第一节　重要声明与提示

一、重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特殊说明，本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股说明书释义相同。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

二、新股上市初期投资风险特别提示

本公司股票将于2022年10月26日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。公司就相关风险特别提示如下：

（一）科创板股票交易风险

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板企业上市首日涨幅限制比例为44%，跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为10%。

科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%；科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。

（二）流通股数量较少的风险

上市初期，原始股股东的股份锁定期为12个月至36个月，保荐机构（主承销商）的母公司依法设立的子公司方正投资跟投股份锁定期为24个月，平安证券伟测科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划锁定期为12个月，网下限售股锁定期为6个月。本次公开发行21,802,700股，发行后总股本87,210,700股。其中，无限售流通股为17,961,243股，占发行后总股本的20.60%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）股票异常波动风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。此外，科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。

首次公开发行股票并上市后，除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

（四）市盈率处于较高水平的风险

本次发行价格61.49元/股对应的本公司市盈率如下：

（1）30.43倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）31.52倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）40.57倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（4）42.03倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本公司所在行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码：C39），截至2022年10月12日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为25.93倍。本次发行价格所对应的市盈率为42.03倍（每股收益按照2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算），高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

三、特别风险提示

（一）公司固定资产折旧较大，且生产设备折旧年限显著长于可比公司，对经营业绩影响较大的风险

截至2021年12月31日，公司固定资产（含使用权资产）的原值为112,872.25万元。报告期各年度，固定资产（含使用权资产）的折旧金额分别为1,506.67万元、3,168.36万元和8,573.66万元，占同期息税折旧摊销前利润的比例分别为44.09%、40.15%和32.85%，固定资产（含使用权资产）折旧对利润的影响较大。公司的固定资产（含使用权资产）主要为生产设备，其折旧年限为5-10年，而同行业可比公司京元电子机器设备折旧年限为2-8年，华岭股份为3-5年，公司生产设备的折旧年限显著长于两家可比公司，主要系公司根据生产设备的使用寿命和未来预计可产生经济利益的年限并结合生产使用过程中的实际情况而综合确定的。若公司参照可比公司京元电子和华岭股份平均折旧年限（即所有专用设备的折旧年限为5年）计提折旧，报告期内，将会减少公司净利润的金额分别为1,019.14万元、2,398.54万元和5,522.05万元，占各期净利润比重分别为90.37%、68.83%和41.78%，将对公司盈利水平产生较大的不利影响。

（二）在建工程投资规模较大的风险

集成电路测试行业是资本密集型行业，设备投入规模较大是行业的典型特征。报告期内，为了支持主营业务的快速发展，公司的在建工程投资规模也随之逐年增加。报告期各年度，公司在建工程分别新增13,529.21万元、38,507.44万元和55,813.18万元，在建工程的各期末余额分别为4,254.69万元、9,581.01万元及10,962.96万元。公司在建工程投资规模较大，一方面产生了较大资金需求，如果公司未能做好投融资方面的规划，可能会给公司带来财务风险；另一方面，未来如果市场需求出现重大变化，可能导致公司的在建工程无法按时投入使用或者转成固定资产后的产能利用率较低，从而发生资产减值的风险，对公司经营业绩造成不利影响。

（三）进口设备依赖的风险

报告期内，公司产能持续扩张，固定资产投资规模持续增长。公司现有机器设备以进口设备为主，主要供应商包括Advantest（爱德万）、Teradyne（泰瑞达）、Semics等国际知名测试设备厂商。公司进口设备主要是测试机、探针台、分选机及相关配件，是公司测试业务的关键设备。截至目前，公司现有进口设备及募集资金投资项目所需进口设备未受到管制。若未来国际贸易摩擦特别是中美贸易冲突加剧，美国进一步加大对半导体生产设备的出口管制力度和范围，从而使本公司所需的测试设备出现进口受限的情形，将对本公司生产经营产生不利影响。

（四）集成电路行业的周期性波动风险

公司主要业务是向集成电路行业中的芯片设计企业、封装企业、晶圆制造企业、IDM企业提供测试服务，与集成电路行业的发展高度相关。全球集成电路行业在技术和市场两方面呈现周期性波动的特点。2011年到2012年，全球集成电路行业平稳发展；2013年到2018年，全球集成电路产业快速发展，销售额快速增长；2019年，全球集成电路产业销售额出现负增长；2020年，因新冠疫情的蔓延以及芯片需求的上升，“缺芯潮”持续演绎，行业发展回暖。2020年至今，集成电路行业处于景气上升的周期，但不排除未来由于行业周期性波动而步入下行周期，从而对发行人的经营业绩产生不利影响。

（五）集成电路测试行业竞争加剧的风险

集成电路测试业务的主要经营主体包括独立第三方测试企业和封测一体化企业两大类。公司是最近几年新崛起的独立第三方测试企业，虽然发展速度较快，但是与封测一体化企业和3家台资独立第三方测试巨头相比，在收入规模、专业技术、获客渠道等方面尚存在较大的差距。在收入规模方面，以日月光、安靠科技、长电科技、通富微电和华天科技为代表的封测一体化企业和京元电子、矽格、欣铨3家全球最大的独立第三方测试巨头的测试服务收入规模是公司的数倍至十多倍不等。在专业技术方面，以日月光为代表的台资封测一体化企业和3家全球最大的独立第三方测试巨头均具有较为深厚的技术积累和技术优势。在获客渠道方面，封测一体化企业利用“封装加测试的一站式服务”的协同获客模式，在芯片成品测试方面具有较强的获客渠道优势，而3家全球最大的独立第三方测试巨头长期面向全球范围的客户提供测试服务，在获取国际知名客户方面具有十分明显的渠道优势。随着集成电路产业景气度的上升，集成电路测试需求也不断扩大，从而吸引了独立第三方测试企业和封测一体化企业等各类测试服务商继续扩大产能、增加投入，市场竞争变得日趋激烈。若公司未来无法在上述几个方面不断缩小与封测一体化企业和独立第三方测试头部企业之间的差距，将有可能在竞争中处于不利地位。

（六）客户集中度较高的风险

2019年至2021年，公司前五大客户的营业收入占公司营业收入的比例分别为42.47%、37.76%和45.22%，报告期末客户集中度较高。若未来公司与下游主要客户合作出现不利变化，或原有客户因市场竞争加剧、宏观经济波动以及自身产品等原因导致市场份额下降，且公司未能及时拓展新客户，则公司将会存在收入增速放缓甚至下降的风险。

四、其他说明事项

本上市公告书“报告期”指：2019年度、2020年度及2021年度。

本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系数字四舍五入所致。

第二节　股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

（一）中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其主要内容

2022年8月19日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1878号），同意本公司首次公开发行股票的注册申请。具体内容如下：

“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司股票上市已经上海证券交易所《关于上海伟测半导体科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕296号）批准。公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，公司A股股本为8,721.07万股（每股面值1.00元），其中17,961,243股股票于2022年10月26日起上市交易。证券简称为“伟测科技”，证券代码为“688372”。

二、股票上市的相关信息

（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

（二）上市时间：2022年10月26日

（三）股票简称：伟测科技

（四）股票扩位简称：伟测科技

（五）股票代码：688372

（六）本次发行完成后总股本：8,721.07万股

（七）本次A股公开发行的股份数：2,180.27万股，均为新股，无老股转让

（八）本次上市的无流通限制及无限售安排的股票数量为17,961,243股

（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为69,249,457股

（十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量为3,052,378股

（十一）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第三节　发行人、实际控制人及股东持股情况”之“五、本次发行前后的股本结构变动情况”

（十二）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节　重要承诺事项”

（十三）本次上市股份的其他限售安排：

1、方正证券投资有限公司参与战略配售获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

2、平安证券伟测科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

3、本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为367个，这部分账户对应的股份数量为789,079股，占网下发行总量的6.97%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.21%，占本次发行总数量的3.62%。

（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（十五）上市保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司

三、本次发行选择的具体上市标准

发行人选择的具体上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第一款：“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”

本次发行价格为61.49元/股，发行后本公司股份总数为8,721.07万股，上市时市值为53.63亿元，不低于人民币10亿元，发行人2021年度实现营业收入49,314.43万元，不低于1亿元。2020、2021年度公司扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润分别为3,260.15万元、12,759.72万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5,000万元，满足在招股说明书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准，即满足《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第一款。

第三节　发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

公司名称	上海伟测半导体科技股份有限公司
英文名称	Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., LTD.
法定代表人	骈文胜
本次发行前注册资本	人民币6,540.80万元
有限公司成立日期	2016年5月6日
股份公司成立日期	2020年9月4日
公司住所	上海市浦东新区东胜路38号A区2栋2F
邮政编码	201201
互联网网址	www.v-test.com.cn
电子邮箱	ir@v-test.com.cn
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
负责信息披露和投资者关系的部门负责人及电话号码	王沛（董事会秘书），021-58958216
经营范围	一般项目：半导体芯片的研发、测试、销售，电子器件制造（除显示器件、集成电路、有分测、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的），电子产品、计算机软硬件的开发及销售，仪器仪表、机电设备的销售，自有设备租赁，从事半导体芯片测试领域内的技术服务、技术咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主营业务	公司是国内知名的第三方集成电路测试服务企业，主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。
所属行业	公司主营业务为集成电路测试服务，根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业分类为“C制造业”门类下的“C3973集成电路制造”小类。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所在行业属于“C制造业”门类下的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司业务属于“1.新一代信息技术产业之2.电子核心产业之1.2.4集成电路制造”。此外，公司所属的行业还是国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019年修订）中的“鼓励类”产业。

二、控股股东、实际控制人的基本情况

（一）控股股东及实际控制人

本次发行前，蕊测半导体持有公司27,032,838股股份，占公司发行前股本总额的41.33%，为公司的控股股东。

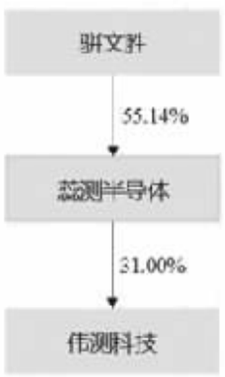
本次发行前，骈文胜先生持有发行人控股股东蕊测半导体51.54%的股份，并通过蕊测半导体控制发行人41.33%的股份，为发行人的实际控制人。公司实际控制人基本情况如下：

骈文胜，男，1970年5月出生，中国国籍，身份证号码12011219700512****，无境外永久居留权，住所为上海市，2016年11月至今担任公司董事长、总经理。

本次发行前，公司控股股东及实际控制人直接或间接持有发行人的股份不存在冻结、质押等权利限制，亦不存在重大权属纠纷。

（二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系

本次发行后，公司与实际控制人的股权结构控制关系如下：



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况及持股情况

（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况

1、董事情况

截至本上市公告书签署之日，本公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名。公司董事基本情况如下：

序号	姓名	职务	任职期间	提名人
1	骈文胜	董事长、总经理	2020.07.18-2023.07.17	蕊测半导体
2	闻国涛	董事、副总经理	2020.07.18-2023.07.17	蕊测半导体
3	路峰	董事、副总经理	2020.07.18-2023.07.17	蕊测半导体
4	陈凯	董事	2020.07.18-2023.07.17	深圳南海
5	祁耀亮	董事	2020.07.18-2023.07.17	江苏聿泉
6	于波	董事	2020.09.09-2023.07.17	苏民无锡
7	徐伟	独立董事	2020.07.18-2023.07.17	蕊测半导体
8	林秀强	独立董事	2020.07.18-2023.07.17	蕊测半导体
9	王怀芳	独立董事	2020.07.18-2023.07.17	蕊测半导体

2、监事情况

截至本上市公告书签署之日，本公司监事会由3名成员组成，公司监事基本情况如下：

序号	姓名	职务	任职期间	提名人
1	乔从缓	职工代表监事、监事会主席	2020.07.18-2023.07.17	职工代表大会
2	高晓	监事	2020.07.18-2023.07.17	南京金浦
3	周歆瑶	监事	2020.07.18-2023.07.17	蕊测半导体

3、高级管理人员情况

截至本上市公告书签署之日，本公司共有高级管理人员5名，高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	性别	职务	任职期间
1	骈文胜	男	总经理	2020.07.18-2023.07.17
2	闻国涛	男	副总经理	2020.07.18-2023.07.17
3	路峰	男	副总经理	2020.07.18-2023.07.17
4	刘琨	男	副总经理	2020.02.17-2023.02.16
5	王沛	女	副总经理、财务总监、董事会秘书	2020.06.27-2023.06.26

4、核心技术人员情况

截至本上市公告书签署日，公司共有核心技术人员4名，核心技术人员基本情况如下：

序号	姓名	性别	职务
1	骈文胜	男	董事长、总经理
2	闻国涛	男	董事、副总经理
3	路峰	男	董事、副总经理
4	刘琨	男	副总经理

（二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属在本次发行前持有公司股份情况如下所示：

股东姓名	关联关系	持股方式	持有股份数量（股）	持股比例（%）
骈文胜	董事长、总经理、核心技术人员	间接	14,646,965	22.39
闻国涛	董事、副总经理、核心技术人员	间接	7,281,621	11.13
路峰	董事、副总经理、核心技术人员	间接	2,924,802	4.47
于波	董事	间接	44,961	0.07
乔从缓	职工代表监事、监事会主席	间接	43,953	0.07
周歆瑶	监事	间接	32,965	0.05
刘琨	副总经理、核心技术人员	间接	54,942	0.08
王沛	副总经理、财务总监、董事会秘书	间接	104,942	0.16
合计			25,135,151	38.43

注：1、骈文胜分别通过蕊测半导体和芯伟半导体间接持有公司13,932,725股和714,240股。闻国涛分别通过蕊测半导体和芯伟半导体间接持有公司7,006,912股和274,709股。路峰分别通过蕊测半导体和芯伟半导体间接持有公司2,595,152股和329,650股；2、于波通过无锡先锋间接持有本公司股份；3、乔从缓、周歆瑶、刘琨、王沛是通过公司员工持股平台芯伟半导体间接持有本公司股份。

截至本上市公告书签署日，除上述情形外，不存在其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接和间接持有发行人股份的情况。

截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接和间接持有的公司股份不存在质押、冻结或其他影响权利的情况，也不存在任何争议。

（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相关限售安排

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定期以及持股及减持意向等承诺详见本上市公告书之“第八节　重要承诺事项”。

（四）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况

截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在持有发行人债券的情况。

四、发行人在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及员工持股计划

发行人部分员工通过合伙企业芯伟半导体持有发行人股份，芯伟半导体本次发行前持有发行人3.44%的股权，股权来源为增资。具体情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例（%）	任职部门或职务
1	龚金新	110	5.24	人力资源部
2	骈文胜	650	30.95	董事长、总经理
3	路峰	300	14.29	董事、副总经理
4	闻国涛	250	11.90	董事、副总经理
5	王沛	150	7.14	副总经理、董事会秘书、财务总监
6	吉晋阳	90	4.29	研发中心
7	傅郁晓	50	2.38	销售客服部
8	芙姜维	50	2.38	研发中心
9	刘琨	50	2.38	副总经理
10	周俊	40	1.90	制造部
11	乔从缓	40	1.90	研发中心
12	徐芳	35	1.67	财务部
13	刘叶	30	1.43	制造部
14	周歆瑶	30	1.43	采购部
15	张伟军	24	1.14	研发中心
16	高大会	20	0.95	制造部
17	左上勇	20	0.95	研发中心
18	孙玉男	20	0.95	销售客服部
19	崔勇彬	20	0.95	制造部
20	史小奇	20	0.95	研发中心
21	马谦	15	0.71	制造部
22	刘栋栋	15	0.71	研发中心
23	袁常乐	15	0.71	研发中心
24	俞磊	10	0.48	研发中心
25	杨恭乾	10	0.48	研发中心
26	宣欢	10	0.48	研发中心
27	张志颖	10	0.48	销售客服部
28	马凯	5	0.24	研发中心
29	李晓奎	5	0.24	研发中心
30	镇淑平	2	0.10	研发中心
31	李亚武	2	0.10	制造部
32	姬悄悄	2	0.10	研发中心
合计		2,100	100	-

（一）员工持股平台确认股份支付情况

1、2019年度

公司股东上海芯伟半导体合伙企业（有限合伙）于2019年设立并对本公司出资，上海芯伟半导体合伙企业（有限合伙）系公司员工持股平台。公司员工通过上海芯伟半导体合伙企业（有限合伙）间接持有本公司1,621,915股，2019年上海芯伟半导体合伙企业（有限合伙）对本公司增资，出资价格为每股12.33元，小于同期投资者直接购买本公司股权的价格，两者的差额以股权支付的形式一次性计入管理费用同时增加资本公积。

2、2020年度

2020年上海芯伟半导体合伙企业（有限合伙）原股东将部分合伙企业的财产份额转让给公司员工，该部分公司员工通过上海芯伟半导体合伙企业（有限合伙）间接持有本公司145,972.35股。公司将员工受让的股份总额（转让价格1,800,000元）与同时期上海芯伟半导体合伙企业（有限合伙）该部分股份公允价值的差额以股权支付的形式一次性计入管理费用同时增加资本公积。

（二）员工持股平台不属于私募投资基金

上述员工持股平台不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金，无需按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定办理私募投资基金备案。

（三）员工持股平台的股份锁定承诺

员工持股平台持有发行人股份的锁定承诺具体请参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”。

截至本上市公告书签署之日，发行人不存在其他未执行或正在执行的对董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和其他员工实行的股权激励（如员工持股计划、限制性股票、股票期权）及其他制度安排。

五、本次发行前后的股本结构变动情况

发行人发行前总股本为6,540.80万股，本次发行股份为2,180.27万股，占发行后总股本8,721.07万股的25.00%。发行人股东不公开发售老股，本次发行前后公司股本结构如下表：

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期
		持股数量（万股）	持股比例（%）	持股数量（万股）	持股比例（%）	
一、有限售条件股份						
1	上海蕊测半导体科技有限公司	2,703.2838	41.33	2,703.2838	31.00	自上市之日起36个月
2	深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）	532.7516	8.15	532.7516	6.11	自上市之日起12个月
3	江苏聿泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）	530.4716	8.11	530.4716	6.08	自上市之日起12个月
4	苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业（有限合伙）	468.4516	7.16	468.4516	5.37	自上市之日起12个月
5	苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）	460.4867	7.04	460.4867	5.28	自上市之日起12个月
6	南京金浦新潮创业投资合伙企业（有限合伙）	308.6086	4.72	308.6086	3.54	自上市之日起12个月
7	中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）	303.5200	4.64	303.5200	3.48	自上市之日起12个月
8	上海芯伟半导体合伙企业（有限合伙）	224.7669	3.44	224.7669	2.58	自上市之日起12个月
9	江苏新潮创新投资集团有限公司	224.0713	3.43	224.0713	2.57	自上市之日起12个月
10	涂洁	168.0867	2.57	168.0867	1.93	自上市之日起12个月
11	顾成标	163.6800	2.50	163.6800	1.88	自上市之日起12个月
12	远海明晟（苏州）股权投资合伙企业（有限合伙）	156.0000	2.39	156.0000	1.79	自上市之日起12个月
13	苏州市德同合心创业投资合伙企业（有限合伙）	140.0000	2.14	140.0000	1.61	自上市之日起12个月
14	广西泰达新原股权投资有限公司	83.6600	1.28	83.6600	0.96	自上市之日起12个月
15	无锡先锋智造投资合伙企业（有限合伙）	44.9612	0.69	44.9612	0.52	自上市之日起12个月
16	克拉玛依云泽裕庆股权投资有限合伙企业	28.0000	0.43	28.0000	0.32	自上市之日起12个月
17	平安证券伟测科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	-	-	218.0270	2.50	自上市之日起12个月
18	方正证券投资有限公司	-	-	87.2108	1.00	自上市之日起24个月
19	网下摇号抽签限售股份	-	-	78.9079	0.90	自上市之日起6个月
小计		6,540.8000	100.00	6,924.9457	79.41	-
二、本次发行的流通股份						
20	无限售条件流通股	-	-	1,796.1243	20.60	无限售期限
小计		-	-	1,796.1243	20.60	-
总股本		6,540.8000	100.00	8,721.0700	100.00	

六、本次发行后公司前10名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	限售期限
1	上海蕊测半导体科技有限公司	2,703.2838	31.00	自上市之日起36个月
2	深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）	532.7516	6.11	自上市之日起12个月
3	江苏聿泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）	530.4716	6.08	自上市之日起12个月
4	苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业（有限合伙）	468.4516	5.37	自上市之日起12个月
5	苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）	460.4867	5.28	自上市之日起12个月
6	南京金浦新潮创业投资合伙企业（有限合伙）	308.6086	3.54	自上市之日起12个月
7	中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）	303.5200	3.48	自上市之日起12个月
8	上海芯伟半导体合伙企业（有限合伙）	224.7669	2.58	自上市之日起12个月
9	江苏新潮创新投资集团有限公司	224.0713	2.57	自上市之日起12个月
10	平安证券伟测科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	218.0270	2.50	自上市之日起12个月

七、本次发行战略配售情况

（一）保荐机构子公司跟投情况

1、跟投主体

保荐机构（主承销商）的母公司依法设立的子公司按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为方正证券投资有限公司。

2、跟投数量

方正证券投资有限公司本次跟投的股份数量为87.2108万股，占本次发行总量的比例为4.00%。

3、限售期

方正证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

（二）发行人高管核心员工专项资产管理计划

1、跟投主体

具体名称：平安证券伟测科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

设立时间：2022年9月1日

募集资金规模：17,684万元（含新股配售经纪佣金）

管理人：平安证券股份有限公司

托管人：兴业银行股份有限公司上海分行

实际支配主体：实际支配主体为平安证券股份有限公司，发行人的高级管理人员及核心员工非实际支配主体

参与人姓名、职务、认购金额及比例如下：

序号	姓名	职务	认购金额（万元）	持有份额比例
1	骈文胜	董事长、总经理	5,000	28.27%
2	闻国涛	董事、副总经理	2,500	14.14%
3	路峰	董事、副总经理	2,271	12.84%
4	王沛	副总经理、财务总监、董事会秘书	1,500	8.48%
5	刘琨	副总经理	1,358	7.68%
6	周俊	无锡伟测总经理	1,200	6.79%
7	吉晋阳	研发中心总监	700	3.96%
8	芙姜维	研发中心总监	600	3.39%
9	乔从缓	监事、研发中心总监	300	1.70%
10	徐芳	财务经理	300	1.70%
11	袁园	无锡伟测副总经理	240	1.36%
12	王刚	制造部厂长	368	2.08%
13	崔勇彬	制造部厂长	400	2.26%
14	傅郁晓	销售客服部总监	175	0.99%
15	周歆瑶	监事、采购部经理	100	0.57%
16	左上勇	研发中心总监	120	0.68%
17	龚金新	人力资源部总监	100	0.57%
18	刘叶	制造部厂长	122	0.69%
19	侯芳	研发中心资深经理	100	0.57%
20	高大会	制造部资深经理	130	0.74%
21	舒畅	制造部资深经理	100	0.57%
合计			17,684.00	100.00%

2、跟投数量

平安证券伟测科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获配股数为218.0270万股，占本次公开发行股份数量的比例为10.00%，获配金额为13,406.48万元，新股配售经纪佣金为67.03万元。

3、限售期

平安证券伟测科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划本次获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

第四节　股票发行情况

一、发行数量

本次发行数量为2,180.27万股，占本次发行后总股本的25%，全部为公开发行新股，无老股转让。

二、每股价格

本次发行价格为61.49元/股。

三、每股面值

本次发行每股面值为人民币1元/股。

四、发行市盈率

本次发行市盈率为42.03倍。（每股收益按照2021年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）

五、市净率

本次发行市净率为2.51倍。（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）

六、发行后每股收益

本次发行后每股收益为1.46元/股（按2021年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算）。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为24.49元/股（按2021年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益以及本次发行募